

北京燕东微电子股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《北京燕东微电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司的主营业务包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务。燕东微以成为卓越的集成电路制造及系统方案提供商为愿景，目前公司拥有 6 英寸晶圆生产线（产能 6.5 万片/月）、一条 6 英寸 SiC 晶圆生产线（产能 2000 片/月）、一条 8 英寸晶圆生产线（工艺节点 110nm，产能 5 万片/月）、一条 12 英寸晶圆生产线（建设过程中，工艺节点 65nm，产能 4 万片/月），主要面向 AIoT、新能源、汽车电子、通讯、超高清显示、特种应用六大领域。公司主营业务属于“半导体行业”，公司所在行业属于科创板重点推荐的“新一代信息技术领域”，公司主营业务属于科技创新领域。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次发行募集资金投资计划

本次发行募集资金总额不超过 402,000.00 万元（含本数），扣除发行费用的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	北电集成 12 英寸集成电路生产线项目	3,300,000.00	400,000.00
2	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		3,302,000.00	402,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（二）募集资金的运用情况

1、北电集成 12 英寸集成电路生产线项目

（1）项目概况

本项目规划建设 12 英寸集成电路芯片生产线，产品主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式 MCU 等领域，搭建 28nm-55nmHV/MS/RF-CMOS 等特色工艺平台，计划建成后产能达 5 万片/月。

（2）项目建设的背景

1) 完善我国集成电路产业生态

半导体产业是支撑我国数字经济和信息产业发展的战略级产业，加快核心技术自主化、实现核心技术国产替代是当前我国半导体行业的主要任务。国家对半导体产业增强自主创新能力、实现科技自立自强、支撑国民经济转向高质量发展和推动形成新发展格局提出了更高要求。

本项目专注于28nm及以上成熟制程，重点服务消费电子、工业、新能源、安防、物联网等领域核心芯片制造，提升芯片产能，增加国产芯片占比，进一步完善我国集成电路产业生态。

2) 服务北京国际科技创新中心建设，提升区域集成电路产业核心竞争力

北京市是国内重要的集成电路创新中心和产业聚集区，承担着国家集成电路产业发展使命。近年来，北京市政府一直将集成电路产业视为需要大力发展的特色优势产业之一。北京“十四五”规划提出“集成电路产业以自主突破、协同发展为重点，构建集设计、制造、装备和材料于一体的集成电路产业创新高地，打

造具有国际竞争力的产业集群”。

北京终端市场需求空间大，芯片设计公司众多，但制造能力尚不能有效满足需求。本项目可与产业链上下游形成产业协同，助力提升产业链供应链韧性，构建集成电路产业创新高地，提升区域集成电路产业核心竞争力。

3) 提高公司集成电路制造核心竞争力

公司是国内最早建设4英寸生产线的企业之一，此后陆续建成6英寸生产线、8英寸生产线、65nm 12英寸生产线，实现了集成电路制造业务的持续发展。本项目技术节点涵盖28nm及以上制程，是公司在集成电路制造领域加大投入、技术不断迭代、能力持续提升的战略举措，符合公司的战略发展规划。

本项目立足高技术水准，推动公司工艺技术能力由现有的65nm向更高工艺节点迈进，进一步加强公司业务在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力。

(3) 项目建设的可行性

1) 符合国家产业政策和行业发展方向

集成电路产业是信息技术产业的核心，具有重要的基础性、先导性和战略性，也是5G移动通信、大数据和云计算等新兴战略产业发展的基石，对国家安全、社会发展具有重要作用。我国高度重视集成电路产业的发展，不仅将其列为战略性新兴产业基础性产业，更是出台多项政策，旨在促进我国集成电路产业的规模扩充及技术提升。

2021年3月，在“十四五”规划中，集成电路被列为“十四五”时期需要“强化国家战略科技力量”的重要领域之一。“十四五”数字经济发展规划中提出要瞄准集成电路等战略性前瞻性领域，集中突破关键核心技术，重点布局第三代半导体等新兴技术。2024年3月，国家发展改革委、工业和信息化部等印发《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，明确享受税收优惠政策的企业条件和项目标准，包括线宽小于 $0.25\mu\text{m}$ （含）的特色工艺集成电路生产企业。

本项目产品面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域，建设28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台，符合国家对于半导体、集成电路领域的政策

支持导向，符合国家的战略发展目标。

2) 项目技术基础扎实、技术来源可靠

本项目依托燕东微现有技术基础，通过技术引进和技术开发相结合的方式建设本项目工艺技术平台。

燕东微通过运营6英寸、8英寸和12英寸生产线，建立了完善的集成电路产线运营体系，在厂务运维、生产过程自动化、工程数据自动化、物流自动化、工艺研发、产品开发等方面积累了丰富的运营经验和深厚的技术基础。同时，公司还为本项目组建了包含厂房建设、工艺集成、工艺开发、产品测试、厂务运营等人员的骨干团队，开展项目论证与筹建。未来公司还将继续投入大量技术人员，充实团队力量，夯实技术基础。

3) 产品定位准确，目标客户明确，市场前景广阔

随着国家不断加大集成电路的投资力度，我国集成电路市场国产化率稳步提升，但在 28nm 及以上成熟制程节点晶圆制造能力仍存在巨大的提升空间。

本项目产品面向显示驱动、数模混合、嵌入式 MCU 等领域，建设 28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS 等特色工艺平台，能够有效满足潜在目标客户对于 28nm 及以上成熟制程节点的晶圆制造需求。

目前，公司已与多家客户开展了战略合作关系，相关客户涉及多个应用场景。该项目产品具备明确的客户来源，市场前景广阔。

2、补充流动资金

(1) 项目概况

公司拟将本次募集资金中的2,000.00万元用于补充流动资金，满足公司战略发展和对运营资金的需求。

(2) 项目的必要性、可行性

报告期内，公司生产经营规模持续扩大，日常生产经营均需要大量营运资金，使得公司对日常营运资金的需求不断增加。通过募集资金补充流动资金，可满足

公司业务开展的新增流动资金需求。在综合考虑公司资金需要、融资规模等因素，公司拟使用2,000.00万元募集资金用于补充公司流动资金。

三、本次募集资金投资属于科技创新领域

1、本次募集资金主要投向科技创新领域

半导体产业是支撑我国数字经济和信息产业发展的战略级产业。公司是国内最早建设 4 英寸生产线的企业之一，此后陆续建成 6 英寸生产线、8 英寸生产线、65nm12 英寸生产线。公司主营业务属于科技创新领域。

本次募投项目专注于 28nm 及以上成熟制程，重点服务消费电子、工业、新能源、安防、物联网等领域核心芯片制造，提升芯片产能，增加国产芯片占比，进一步完善我国集成电路产业生态，提高公司科技创新水平。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

2、本次募投项目的实施将促进公司科技创新水平的显著提升

公司所处的行业具有研发投入大、技术升级迭代快、研发周期长等特征，本次募投项目规划建设 12 英寸集成电路芯片生产线，产品主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式 MCU 等领域，搭建 28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS 等特色工艺平台，推动公司工艺技术能力由现有的 65nm 向更高工艺节点迈进，提高公司服务相关行业的能力，进一步提升公司技术先进性。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日